

成分表

製品名(鉛フリー): XCL205xxxxAR-G
標準重量: 20 mg

部位	名称	重量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CASナンバー	
コイル	コア(フェライト)	7.680	酸化鉄	384000	1309-37-1	
		2.363	酸化亜鉛	118200	1314-13-2	
		1.300	酸化ニッケル	65000	1313-99-1	
		0.473	酸化銅	23600	1317-38-0	
	ベース基板	0.105	ビスマレイド・トリアジン樹脂/エポキシ樹脂	5300	-	
		0.068	無機フィラー	3400	-	
		0.203	ガラスクロス	10100	65997-17-3	
	中間保護膜樹脂A	0.054	エポキシ樹脂	2700	25068-38-6	
		0.121	シリカ	6000	-	
	保護膜樹脂B (トップコーティング)	0.043	エポキシ樹脂	2200	25068-38-6	
		0.096	シリカ	4800	-	
	接着樹脂	0.290	エポキシ樹脂	14500	25068-38-6	
		0.646	シリカ	32300	-	
	導体(巻線部)	2.340	銅	117000	7440-50-8	
	端子メッキ	0.043	ニッケル	2200	7440-02-0	
		0.118	錫	5900	7440-31-5	
	接着剤	0.034	エポキシ樹脂	1700	-	
		0.025	シリカ	1300	14808-60-7	
	IC	シリコンチップ	0.433	シリコン	21700	7440-21-3
			-	砒素	<1	7440-38-2
リードハット		1.223	ニッケル	61100	7440-02-0	
		0.113	銀	5700	7440-22-4	
		0.022	金	1100	7440-57-5	
ダイアタッチ		0.023	エポキシ樹脂	1200	-	
		0.018	シリカ	900	60676-86-0	
ボンディングワイヤ		0.071	金	3500	7440-57-5	
封止樹脂		1.626	熔融シリカ	81300	60676-86-0	
		0.165	エポキシ樹脂	8300	-	
		0.155	フェノール樹脂	7800	-	
		0.151	金属水酸化物	7500	-	

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。